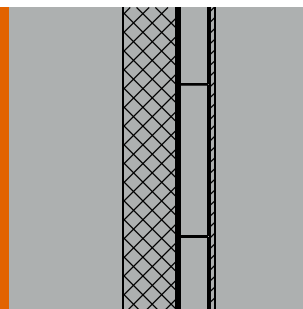


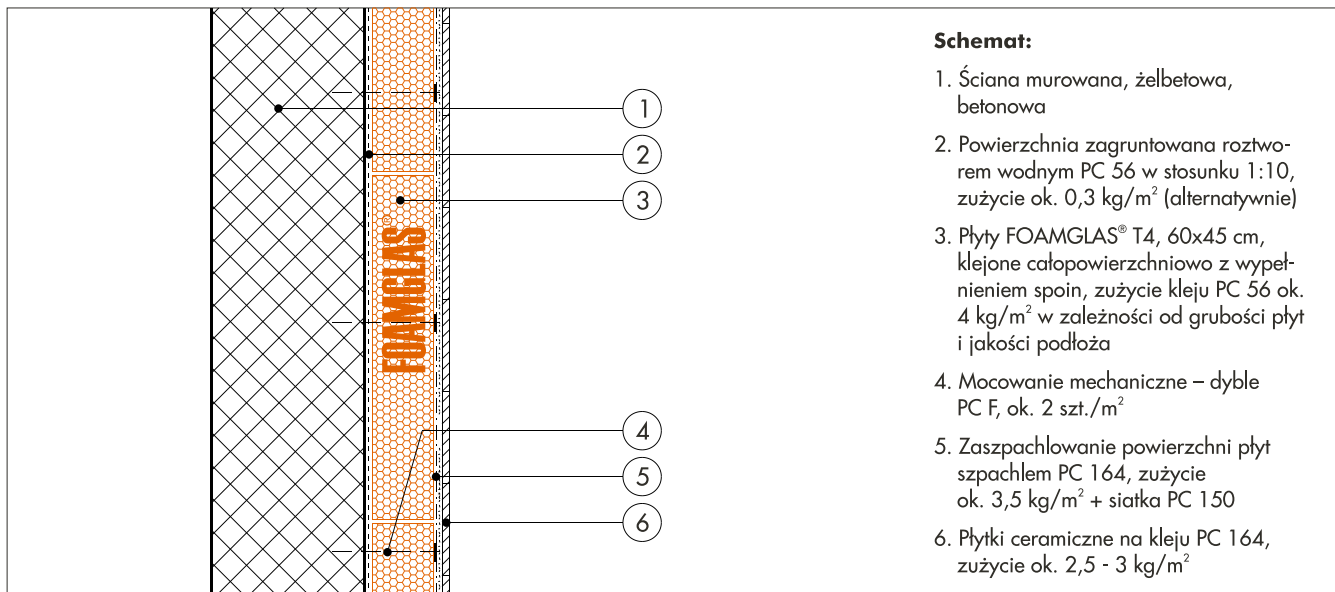
Termoizolacja ściany

Warstwa termoizolacyjna z płyt FOAMGLAS® T4 z wykończeniem płytkami ceramicznymi



FOAMGLAS®

Konstrukcja



6.1.2 s1

Zalety stosowanego materiału i rozwiązania

- możliwość bezpośredniego klejenia płytek do płyt FOAMGLAS®
- ciągła warstwa termoizolacyjna
- konstrukcja paroszczelna
- łatwość wykonania, szybki postęp prac
- rozwiązanie ekologiczne
- w przypadku rozbioru łatwa segregacja materiałów
- duża wytrzymałość na ściskanie, izolacja nie osiada
- materiał odporny na działanie czynników chemicznych i biologicznych
- stała ochrona termiczna w czasie użytkowania obiektu

System stosowany szczególnie w przypadkach pomieszczeń użytkowanych i ogrzewanych okresowo: kościoły, sale konferencyjne lub pomieszczeń z podwyższoną wilgotnością przy wysokiej temperaturze np. pływalnie – eliminacja możliwości tworzenia się kondensatu na powierzchni i w przekroju ścian, stropów.

Zapotrzebowanie materiałów / przebieg prac

- powierzchnię muru oczyścić z kurzu, tłuszczu
- zagruntowanie powierzchni ściany - polepszenie przyczepności podłoża, zużycie roztworu wodnego kleju PC 56, 1 : 10, 0,3 kg/m² (alternatywnie)
- klej PC 56 nałożyć na jedną krótszą i jedną dłuższą krawędź płyty (jednocześnie dla kilku płyt)
- płyty FOAMGLAS® T4, 60x45 cm, kleić całopowierzchniowo z wypełnieniem spoin, zużycie kleju PC 56 ok. 4 kg/m² w zależności od grubości płyt i jakości podłoża, klej nakładać packą zębatą o wysokości zębów 6-10 mm
- płyty przyklejać rzędami z przesunięciem spoin pionowych dociskając do uprzednio ułożonej płyty, wyciśnięty nadmiar kleju usunąć
- ewentualne nierówności powierzchni przeszlifować packą z papierem ściernym
- grubość warstwy termoizolacyjnej zależna od wymaganego współczynnika przenikania ciepła U
- powierzchnię zewnętrzną płyt zaszpachlować PC 164 po 1-3 dniach od klejenia płyt, zużycie 3,5 kg/m², z wtopieniem siatki zbrojeniowej PC 150
- stosować mechaniczne mocowanie płyt przy pomocy łączników PC F, ok. 2 szt./m²
- płytki ceramiczne należy kleić po upływie 8-10 dni od nałożenia podkładu zapewniając odparowanie wody z podkładu, szczególnie ważne jest odprowadzenie wilgoci z podkładu w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 0°C np. chłodniach
- przyklejanie płytek klejem PC 164 lub klejem do płytek na bazie PU, nanoszenie kleju packą zębatą o wysokości zębów 6-10 mm
- w przypadku dużych powierzchni oraz przy narożnikach należy przewidzieć elastyczne spoiny
- prace należy wykonywać w temperaturze > 5° C